三集瑞科技 國際集團股份有限公司
TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.

2026年第二季營運報告

報告人：林伙利董事長

股票代號：6862

經營實績


Customization & Innovation
Cost efficient v.s. high quality products

貳:經營實績

➢ 簡明損益表

會計科目	2023年度	2024年度	2025年度	2026年上半年
營業收入	1,594,621	2,200,240	2,265,718	911,645
營業成本	857,300	1,285,173	1,354,351	603,956
營業毛利	737,321	915,067	911,367	307,689
營業費用	251,213	370,870	353,493	187,843
營業利益	486,108	544,197	557,874	119,846
營業外收入及支出	5,755	129,607	-45,230	4,297
稅前淨利	491,863	673,804	512,644	124,143
所得稅費用	99,527	158,181	98,133	40,040
稅後淨利	392,336	515,623	414,511	84,103
每股盈餘	9.02	11.41	8.29	1.68

單位：新台幣仟元

貳:經營實績(續)

NT$仟元	2025年Q1	2025年Q2	2025年Q3	2025年Q4	2025年合計	2026年Q1	2026年Q2	2026年合計
營業收入	610,380	649,029	503,013	503,296	2,265,718	471,241	440,404	911,645
營業成本	362,834	367,553	311,865	312,099	1,354,351	317,837	286,119	603,956
營業毛利	247,546	281,476	191,148	191,197	911,367	153,404	154,285	307,689
營業費用	93,079	81,902	80,561	97,951	353,493	92,656	95,187	187,843
營業利益	154,467	199,574	110,587	93,246	557,874	60,748	59,098	119,846
營業外收入及支出	40,891	-188,375	55,409	46,845	-45,230	9,819	-5,522	4,297
稅前淨利	195,358	11,199	165,996	140,091	512,644	70,567	53,576	124,143
所得稅費用	35,623	11,182	24,931	26,397	98,133	20,430	19,610	40,040
淨利歸屬於母公司業主	159,735	17	141,065	113,694	414,511	50,137	33,966	84,103
EPS	3.19	0.00	2.82	2.27	8.29	1.00	0.68	1.68

重要財務比率（%）								
毛利率	40.56%	43.37%	38.00%	37.99%	40.22%	32.55%	35.03%	33.75%
營業費用率	15.25%	12.62%	16.02%	19.46%	15.60%	19.66%	21.61%	20.60%
營業利益率	25.31%	30.75%	21.98%	18.53%	24.62%	12.89%	13.42%	13.15%
稅率	18.23%	99.85%	15.02%	18.84%	19.14%	28.95%	36.60%	32.25%
淨利率	26.17%	0.00%	28.04%	22.59%	18.29%	10.64%	7.71%	9.23%

單位：新台幣仟元

貳:經營實績(續)

2026年Q2營運成果

- ✓ 本公司2026年截至第二季度營業收入為新台幣9.1億元，較去年同期新台幣12.59億元，減幅為27.61%。
- ✓ 本期淨利為新台幣84,103仟元，較去年同期新台幣159,752仟元減少75,649仟元，減少47.35%。
- ✓ 每股盈餘為1.68元。

主要因素

- ✓ 受到全球記憶體供需吃緊影響，部分供應鏈拉貨動能放緩，在整體產能利用率未達經濟規模下，使獲利表現略低於預期。

貳:經營實績(續)

➢ 簡明資產負債表

NT$仟元	2023/12/31	2024/12/31	2025/12/31	2026/3/31	2026/6/30
資產總額	2,783,725	3,971,774	4,450,719	5,565,992	5,217,563
現金及約當現金	634,049	1,033,514	717,589	1,689,547	1,316,618
應收帳款及票據	676,252	904,614	830,491	818,191	710,878
存貨	253,181	381,794	334,204	418,377	422,801
不動產廠房及設備	659,540	999,472	1,883,384	1,896,050	2,048,423
負債總額	1,313,777	1,085,105	1,466,240	2,438,059	2,319,518
應付帳款及票據	218,567	387,349	273,865	345,576	240,715
權益總計	1,469,948	2,886,669	2,984,479	3,127,933	2,898,045
股本	440,000	500,000	500,000	500,000	500,000
重要財務比率（%）					
應收帳款天數	127.56	131.13	139.76	159.62	154.28
存貨週轉天數	103.16	90.17	96.48	108.03	114.37
應付帳款週轉天數	71.97	86.04	89.10	88.92	77.75
現金循環週期	158.75	135.25	147.14	178.74	190.91
ROE(%)	30.12%	23.67%	14.12%	1.64%	2.86%
ROA(%)	17.18%	15.71%	10.05%	1.10%	1.99%

單位：新台幣仟元

貳:經營實績(續)

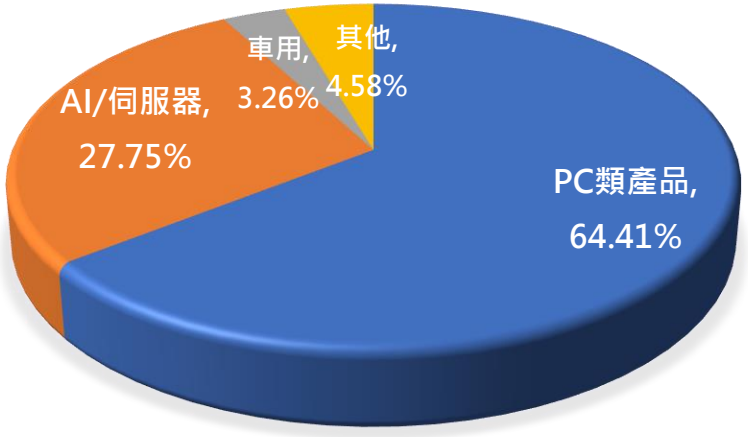
營收成長趨勢分析 (MoM / YoY)

- MoM 強勁回升：6月增長 +28.3%，7月續增至 192M (+14.7%)，8月站穩 173M 高檔，第三季整體出貨節奏大幅超越第二季。
- YoY 跌幅大幅收斂：雖然傳統消費 PC/NB 需求尚未回到疫情前水準，但受惠 AI Server 與 Server Power 高價值產品放量，7~8月營收年減幅度大幅收斂。
- 淡旺季反轉：擺脫過去完全受 PC 淡旺季牽制的波動，形成由 AI 資料中心與高瓦數電源引領的新營收軌道。
- 營運谷底已確立跨越：公司已走出最低點，AI 與高功率電源成為支撐營收核心基石。

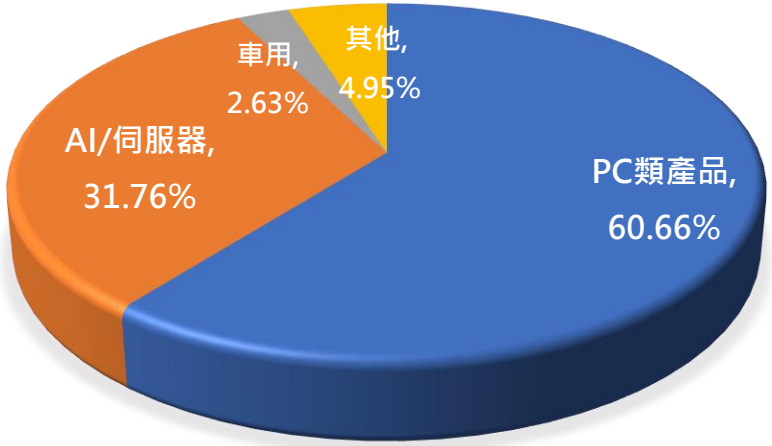
貳:經營實績-應用市場(續)

應用領域	2023年度	2024年度	2025年度	2026年截至8月
PC類產品	78.52%	64.41%	60.66%	40.46%
AI/伺服器	13.03%	27.75%	31.76%	36.22%
BBU	0%	0%	0%	10.24%
車用	1.17%	3.26%	2.63%	6.40%
其他	7.28%	4.58%	4.95%	6.68%
合計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

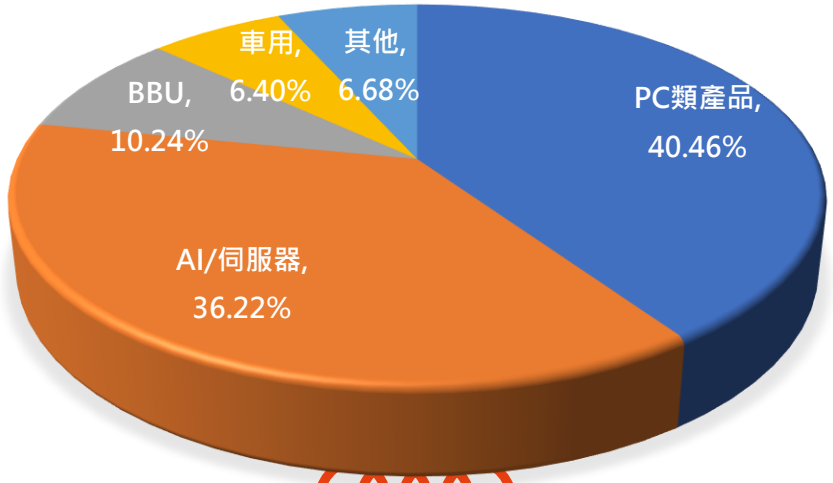
2024年度



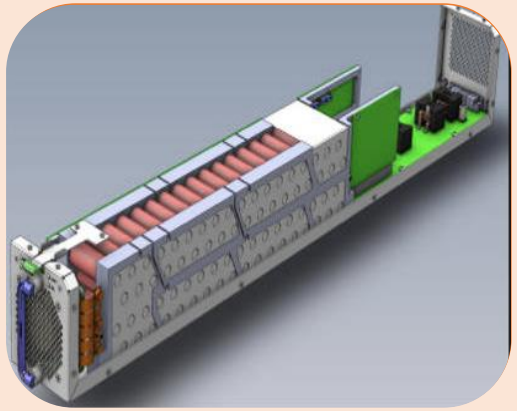
2025年度



截至2026年8月

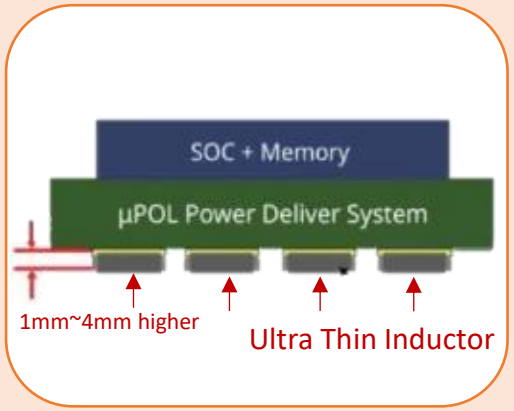


參:未來發展策略_產品方向



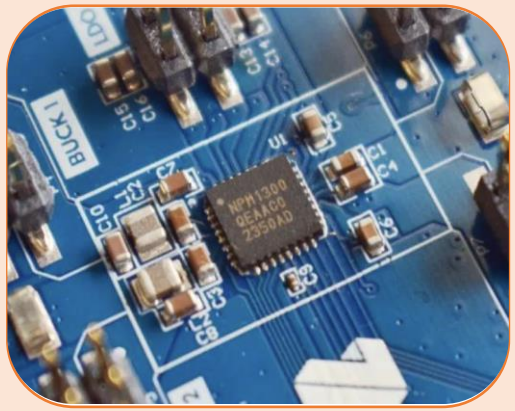
大功率電源供應器 (大電流磁性元件)

- 因應AI伺服器機櫃機構設計，設計高功率密度磁性元件。
- 使用高性能磁性材料，配合新式線路架構，高度客製化功率磁件。
- For SST/HVDC應用高絕緣設計。



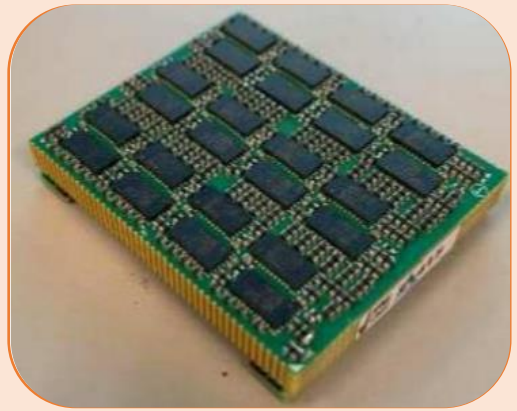
垂直供電應用 (VPD) (低高度電感)

- 電路板上的設計空間有限，將功率電感器放置在電路板下方，有效利用底部金屬機構設計散熱。
- 特低高度電感器設計。
- 最短的電源路徑可提高效率。



PMIC (微型化電感)

- NPU/CPU 低功耗多線式供電需求，PMIC方案提供完善DC/DC供電。
- 成熟且完整的高密度電感製程完成微型電感mini molding開發。



電源模塊 (集成式電感)

- 與IC/ASIC方案商合作開發電源模塊電感，DC/DC整合式電源解決方案可提高功率密度。
- 第一級(48~52V/12V)與第二級(12/1V)完整方案。
- 最小體積&最大功率密度。

參:未來發展策略_AC/DC電源轉換磁件

- BBU(Battery Backup Unit)：
  - AI伺服器電源架構中的備援電池系統，17kW/23.5kW電源廠客戶新案LLC電感與變壓器開發中，預計Q4送樣。
  - 目前開發方向以縮小磁件體積，並提升產品效能與功率密度為目標。



Nvidia ORV3 MGX



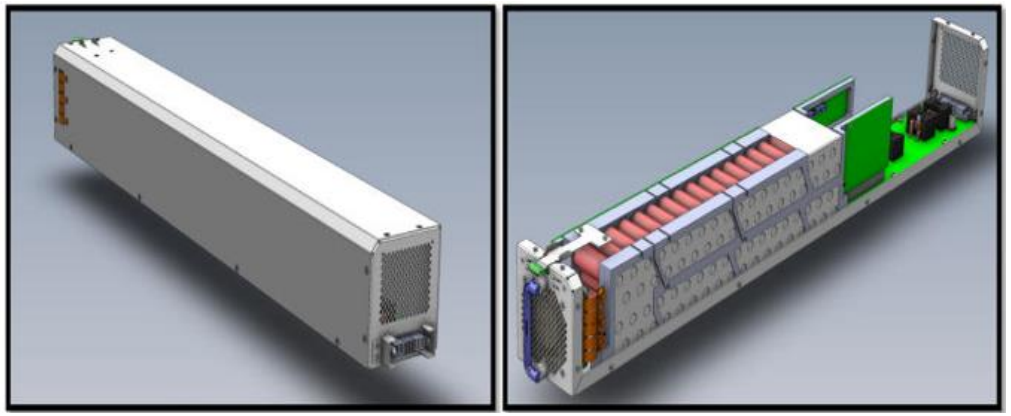
Nvidia GB300 NVL72



Nvidia RUBIN 800HVDC

- 800V HVDC AC/DC PSU：
  - 因應未來液冷式散熱與高功率密度需求，新的一體成型PFC電感開發中，預計Q4送樣給終端電源廠客戶。
  - 26kW/30kW專案進入EVT階段。





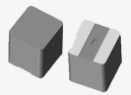
- SST固態變壓器：
  - 新增20kW/35kW固態變壓器開發，目前製樣中，預計Q4完成送樣。

參:未來發展策略

- 垂直供電 (Vertical Power Delivery, VPD)：
  - 運用高密度電感製程開發系列低高度電感產品，目前高度以1.2mm/1.5mm/1.8mm等為主要目標，已陸續開發並試樣。
  - 低高度2相/4相電感開發中，預計Q4完成初步製樣。
- 電源模塊電感 (Power Module Inductor)：
  - 與IC與ASIC廠商合作開發多個電源模塊電感專案，目前已開發有14款電感，已陸續開發試樣，預計下半年進入量產。
  - 新增4款電源模塊電感開發，其中一體成型1款，組裝式3款，預計Q4完成試樣定版，明年Q1試產。

高功率電感(低高度)
- 高功率密度
- 大電流設計
- 耦合電感設計
- 雙繞組/多繞組電感設計

Single Inductor MP
HM/FM Series
A23_85nH



Flat Inductor Sample
HM Series
For VGA, AI application



Dual Inductor MP
HM/FM Series
A24_Dual 85nH

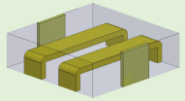


TLVR Inductor Sample
HM Series
A51_100nH



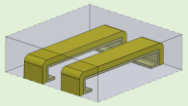
電源模塊電感
- 高度整合設計
- 完全客製化開發
- 多相式TLVR設計

Dual phase module Inductor MP
HM Series
Dual_60nH
9.0*2.4*7.2

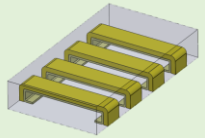


Multi phase TLVR module Inductor
HM Series

MP

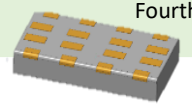


Sample



Dual_65nH

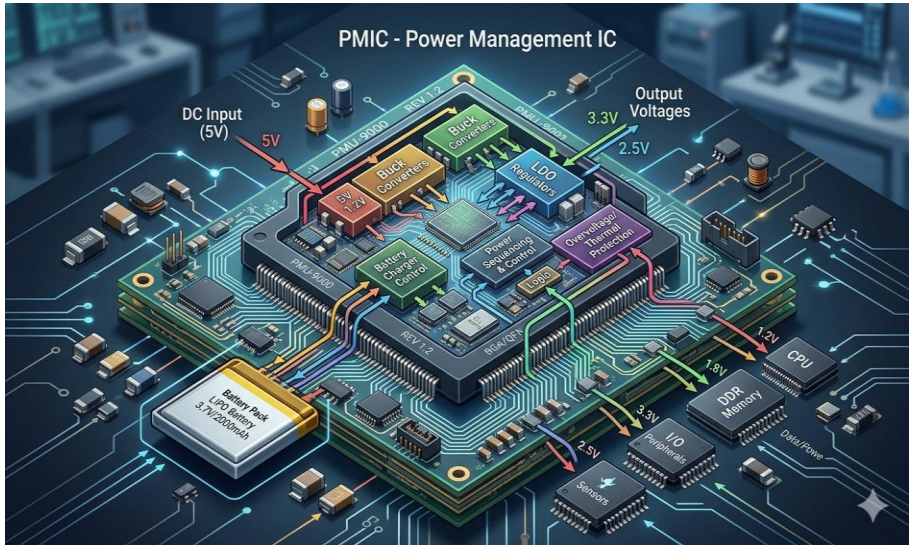
Fourth_45nH

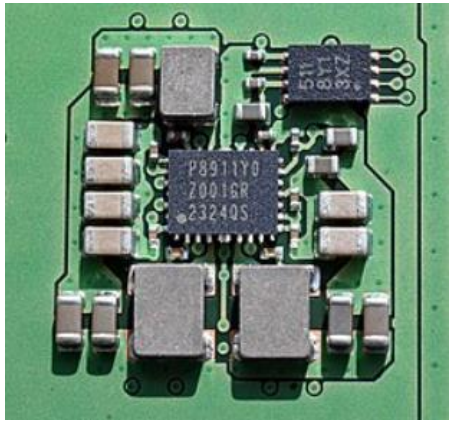


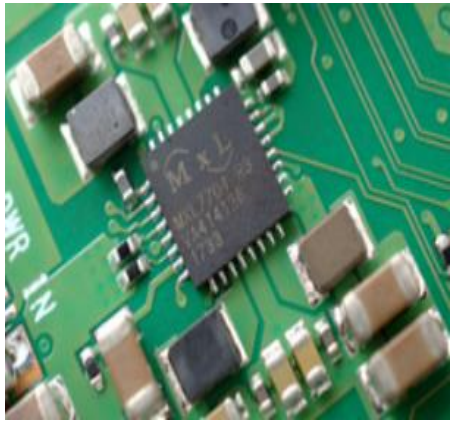
參:未來發展策略_PMIC

- PMIC (Vertical Power Delivery, VPD)：
  - 對應高通(Qualcomm)或英特爾(INTEL) CPU/NPU平台，搭配PMIC供電，開發Mini Molding產品，已完成全系列從3225~1412全尺寸產品開發。
  - 小尺寸1005樣品送樣測試中。

Series	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Inductance (μH)	DCR Range (mΩ)	Irms (A)	Isat (A)
HP-13E	1.4	1.2	0.8	0.24 ~ 1	22 ~ 65	4.1 ~ 3	6 ~ 3
HP-02E	1.6	0.8	0.8	0.22 ~ 10	33 ~ 1450	3.4 ~ 0.5	5.5 ~ 0.8
HP-03E	2.0	1.2	0.8	0.11 ~ 4.7	10 ~ 285	7 ~ 1.7	9.5 ~ 1.6
HP-03T	2.0	1.2	1.0	0.1 ~ 10	8 ~ 600	7.5 ~ 1.5	8.5 ~ 1.2
HP-04E	2.0	1.6	0.8	0.22 ~ 10	14 ~ 690	6.6 ~ 1	6.1 ~ 1
HP-04T	2.0	1.6	1.0	0.1 ~ 10	7 ~ 485	8.5 ~ 1	9 ~ 1.4
HP-04B	2.0	1.6	1.2	0.1 ~ 4.7	4 ~ 165	12 ~ 2.4	13 ~ 2.7
HP-05T	2.5	2.0	1.0	0.1 ~ 22	6.8 ~ 1100	9 ~ 0.85	9.2 ~ 1.1
HP-05B	2.5	2.0	1.2	0.1 ~ 10	10 ~ 330	9.5 ~ 1.2	13.5 ~ 1.6
HP-07B	3.2	2.5	1.2	0.1 ~ 10	5.2 ~ 210	12 ~ 2.2	18 ~ 2.3







參:未來發展策略_TLVR

- TLVR 產品開發與推廣：
  - Nvidia Rubin Ultra與Feynman平台的低高度TLVR完成開發，目前送測階段。
  - INTEL和AMD伺服器CPU平台已完成TLVR產品系列開發，並完成量產與導入國內外伺服器大廠。
  - Molding TLVR產品已導入品牌大廠，首批完成交付，預計下半年進入量產。

intel XEON

Eagle Stream
Emerald Rapids
10nm++
DDR5
350-400W

Birch Stream
Granite Rapids
3nm
DDR5
400W+

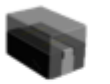
AMD EPYC

AMD Zen4
Genoa
5nm
DDR5
320-400W

AMD Zen5
Turin
3nm/4nm
DDR5
380-600W


MP

Assembly Type (VR/LC)
EB-5LP Series
(10mm*6mm*12mm)
EB-4LP Series
(10mm*5mm*12mm)


MP

Assembly Type (LC)
EB-4YP Series
(9.6mm*6.4mm*8.0mm)
EB-5RP Series
(6.5mm*6.5mm*10mm)


MP

Assembly Type VR (VR/LC)
EB-5LP Series
(10mm*6mm*12mm)
EB-4LP Series
(10mm*5mm*12mm)


MP

Assembly Type (LC)
EB-4YP Series
(9.6mm*6.4mm*8.0mm)
EB-5RP Series
(6.5mm*6.5mm*10mm)


MP

Molded Type (High Density)
HM-A19VT Series (6060)
HM-A20VT Series (1060)
HM-A21VT Series (1010)
HM-A28VT Series (8080)
HM-A29VT Series (1510)


MP

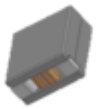
Assembly Type TLVR
EB-7LS Series
(12mm*6mm*11mm)
EB-5LS Series
(10mm*6mm*12mm)
EB-4LS Series
(10mm*5mm*12mm)


MP

Assembly Type TLVR
EB-7NS Series
(12mm*6mm*8mm)


MP

Assembly Type TLVR
EB-5QS Series
(11mm*7.5mm*12mm)
EB-5GS Series
(12mm*6mm*12mm)


MP

Assembly Type TLVR
EB-5MS Series
(9mm*5mm*12mm)



MP

Molded Type TLVR
HM series
11mm*6mm*7.5mm
10mm*5mm*10mm



Sample

Molded Type TLVR
HM series
7.5mm*7.5mm*13mm

參:未來發展策略

- **AC/DC電源轉換磁件：**
  - Server Power：高階雲端資料中心伺服器電源標準料件全面滲透。
  - 集中式機櫃 BBU：成為新世代 AI 資料中心備援電池模組主要電感供應商。
  - 高瓦數 Power 模組：布局下一代 20kW+ 超高功率密度的核心料件。
  - 產品策略：持續提高 HVDC 與高毛利 BBU 占比。

- **GPU與加速卡市場：**
  - 中國 GPU 生態圈布局最完整：深度卡位中國主要自主 AI 算力晶片原廠。
  - 國產替代浪潮：受惠算力自主政策推動，寒武紀與雲尖出貨規模持續放大。
  - 管理意義：TRIO 在中國 AI 伺服器與加速卡市場最不可或缺的開拓核心。

- **PMIC/ 高密度電感：**
  - Intel / AMD 次世代：積極導入 Panther Lake、Nova Lake 及 AMD Halo 高階平台。
  - Qualcomm 伺服器：配合高通 AI 晶片架構進行電感樣品驗證， TRIO 正式從傳統 PC 跨入 Mobile AI、高通 PC 與 PMIC 電源晶片生態圈。
  - 大電流低高度：鎖定下一代 GPU/CPU 核心供電所需之極限規格。

- **機器人與邊緣運算：**
  - 機器人市場持續追蹤：機器人控制主板與伺服馬達驅動電感具高潛力。
  - 邊緣設備延伸：鎖定智慧安防、物聯網閘道器等長尾穩定型利基市場。
  - 管理建議：優化客戶結構，提升高單價工業級料件滲透率。

經營重點摘要

一、營收結構深化轉型

產品結構由傳統 PC/NB/MB/VGA 全面轉向 AI Server、Power/BBU、HVDC、新能源車載。

AI + Server + Power 占比突破 55%，獲利結構大幅優化。

二、未來成長動能三主軸

確立三大主軸：AI Server、Power/HVDC/BBU、China AI Server& EV 。

同步積極卡位 2028 SST 與 PowerSiP 關鍵世代。

產業轉型狀況與技術演進

過去導向

- 核心應用：PC、VGA、MB、消費型 NB 標準電感。
- 競爭模式：依賴台灣 ODM 系統廠，價格競爭激烈， 毛利受壓。
- 市場特徵：出貨數量龐大 (KK級)，但 ASP 低 。

現在與未來導向

- 核心應用：AI Server (GB200/300)、CSP Hyperscaler 直供、HVDC 集中供電、車用電力系統
- 競爭模式：與晶片原廠 (NVIDIA/Qualcomm/Infineon) 及 CSP 直接對接規格制定。
- 市場特徵：大電流、低高度、耐高溫高壓，ASP 顯著提升。

Thank You

三集瑞科技 國際集團股份有限公司

TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.